

非破壊

レーザーボンドテスター

# Laser Bond Tester I + Magazine Changer

業界初！



< 全自動測定 >

アルミワイヤボンドの 非破壊 非接触 瞬時測定 を初実用化！

**iL Technology**

Technologies of Infrared measurement and Laser control

Ver. 2.0

## 概要仕様

測定方法	レーザー周期加熱式接合部位測定法 *4)
測定対象	アルミワイヤ接合部位 *1) ワイヤ径: $\phi 200\mu\text{m} \sim \phi 400\mu\text{m}$ *2)
測定値	位相値(接合部位の熱抵抗と強相関)
測定結果表示	位相値・接合面積 *3)・接合係数 *3)・変換値分布グラフ(下限上限閾値を設定)・ 変換値変位グラフ(測定安定時間を確認)・測定値強度ベクトルグラフ・良否判定
測定結果出力	画面表示及びCSVファイル内容
測定時間	ボンド当たり実質測定時間: 100ms~300ms/ボンド 位置移動時間及び画像処理時間: 0.5~3秒/ボンド
リードフレーム寸法	W: 20mm~110mm L: 90mm~300mm t: 0.1mm~0.5mm
マガジン寸法	W: 30mm~120mm L: 100mm~310mm H: 100mm~200mm
マガジンストック数	3個
画像処理機能	最適測定位置認識機能・簡易寸法測定・つぶれ幅測定
レシピ作成	手入力・ティーチング入力・外部作成データ入力・座標変換(オプション)
レシピ入力情報	マガジン情報・リードフレーム情報・ボンド情報・測定条件・良否判定等
電源	三相AC200V 30A/max・要接地(D種)
測定用レーザー	半導体レーザー *1) *2)
使用レーザークラス	クラス4: JIS C 6802:2018 / IEC 60825-1:2014 準拠
装置レーザークラス(通常運用時)	クラス1相当
装置安全基準	ISO13849-1 / JIS B 9705:2019 準拠
装置本体外形寸法	W: 1500mm D: 1400mm H: 1600mm *5) (暫定仕様)
重量	約650kg (暫定仕様)
動作環境	温度: 22~25°C・湿度: 85%RH以下・粉塵無き事

※1) 測定対象毎に測定条件や加熱レーザーの調整などが必要です。

※2) 本装置のレーザーはクラス4製品です。ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けて下さい。

※3) 回帰式による変換値です。

※4) 測定方法は、株式会社ジェイテクトのpatentに基づいています。

※5) 外形寸法は突起部を含みません。筐体部分のみの寸法で、上部のパラライト寸法などは含まれていません。

※6) 本装置は温度調整ユニット用に工業用純水が必要です。(内部循環式)

※7) 本装置は機能・性能向上の為、お断りなく仕様変更される場合があります。

※8) “レーザーボンドテスター”及び“Laser Bond Tester”は、アイエルテクノロジー株式会社の登録商標です。



製造元

**iL Technology Corporation**

アイエルテクノロジー株式会社

愛知県岡崎市針崎1丁目1番地13

TEL: 0564-73-2005

URL: <http://www.il-tech.jp>